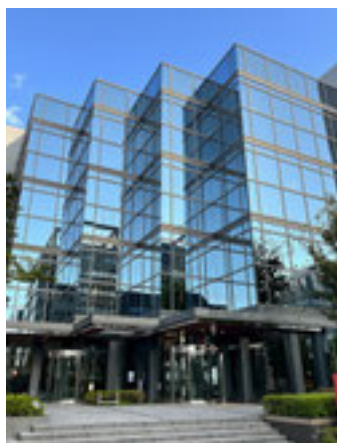


<https://www.fpdforum.org/>第 49 回 fpd フォーラム/

第 49 回 FPD フォーラム



開催概要



■開催日 2026 年 10 月 16 日(金)
10 時より受付開始、10 時 45 分講演開始

■会場 京都リサーチパーク アクセス
京都駅より JR 嵯峨野線(山陰線)2 駅(約 5 分)
丹波口駅下車 西へ徒歩 5 分
講演会パート 1 号館 4 階サイエンスホール

交流会パート 1 号館 1 階 アトリウム

■メインテーマ

日本半導体ビジネス復活に向けた注目技術

本フォーラム『日本半導体ビジネス復活に向けた注目技術』では、注目される半導体の後工程にフォーカスを当て、パッケージ先端実装の専門家をお招きし、最新の技術動向と将来展望を多角的に議論します。

■交流会形式 指定席(着席ビュッフェ)

■参加費:

- ① 参加 1 名 40,000 円(税込) (* 1)
- ② 参加 1 名+企業小展示1コマ 50,000 円(税込) (* 2)
- ③ 参加 1 名+学術ポスター発表1コマ 40,000 円(税込) (* 3)

(* 1) 参加費には、昼食弁当・交流会の食事代を含みます。食事が不要の場合も価格は一律です。

(* 2) 企業小展示枠は、各社代表の方お一人がお申し込みください。複数コマの申込の場合は申込の前に別途事務局にご連絡ください。

(* 3) 大学等教育機関からの学術ポスター発表は技術興の趣旨に則り無料とします。

上記①②③のいずれか 1 枚が購入できます。Peatix 上で複数種類のチケットが選択できるようになっていますが、1 申込につき 1 種類 1 枚でお願いします。

FPD フォーラムにはインボイスの T の番号はございませんので、予めお知らせしておきます。

■企業小展示・学術ポスターの仕様

1 コマにつき、

パネル・社名が印刷された紙(A4 サイズ)が1つずつ付きます

机のサイズ:

W1,800mm×D450mm×H700mm

パネルのサイズ:

W900mm×H2,000mm

* 学術ポスターには机は付きません。

過去の同会場での小展示の様子は[こちら](#)からご覧いただけます (YouTube)

■企業小展示 ご出典特典

ランチョントークでスピーチの時間がございます(1 社 3 分予定)



■参加申込

Peatix からお申込みください。

<https://fpd49.peatix.com>

(申込締切 2026 年 10 月 9 日(金)正午)

■お問合せ

FPD フォーラム事務局

オフィス モロはん officemorohan@gmail.com

TEL 075-406-0982

Instagram : @office_morohan

✉ 事務局へのご連絡は、Peatix のメッセージ機能またはメールをご利用ください。添付ファイルがある場合は、メールでお

願いいたします。

※電話は不在の場合がございますので、あらかじめご了承ください。

プログラム



10:00 受付開始 (小展示出展企業様 準備開始)

10:45 OPENING REMARKS 開催趣旨講演

FPD フォーラム幹事 **西田 秀行** (株式会社 NEP Tech, S&S, ニシダエレクトロニクス実装技術支援 代表取締役)

11:15 講演 1

竹内 裕之 (東レエンジニアリング株式会社 メカトロファインテック事業本部第一事業部 営業部 営業1チーム シニアマネージャー)

「ハイエンド半導体を支えるパネルレベルパッケージング技術と当社ボンダーソリューション」

11:50 ランチョン トーク (お弁当付き)

出展者による Abstract Talk

～小展示見学・交流・休憩～

12:50 講演 2

安達 佳孝 (オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー(IAB) 検査システム事業本部 半導体検査プロジェクト シニアプロダクトマネージャー)

「半導体・電子デバイスでの 3D X 線解析が実現する品質言語化」

13:20 講演 3

山本 義継 (みずほ証券株式会社 エクイティ調査部 シニアアナリスト)

「Agentic AI の拡大で先端プロセス/先端 PKG の需要が切り上がる」

14:10 講演 4

高橋 正樹 (株式会社レゾナック パッケージング & パワーソリューションセンター)

「パネルレベルの最先端半導体パッケージに関する Resonac の取り組み (仮)」

14:45 コーヒーブレイク・展示見学

15:30 講演 5

川上 雄介 (株式会社ニコン 精機事業本部 次世代事業開発統括部 Senior Researcher)

「Nikon が提案する最先端半導体パッケージ向け配線技術」

16:10 講演 6

高橋 志津 (日本アイ・ビー・エム株式会社 研究開発 理事 Technology Engagement & Acceleration / 京都リサーチパーク株式会社 事業所長)

「Future is There ～コンピューティングの進化と転換点～」

16:55 CLOSING REMARKS

FPD フォーラム代表幹事 北原 洋明

(テック・アンド・ビズ株式会社)

17:00 写真撮影・交流会場への移動

(出展者片付け)

17:30 交流会

(19:30 終了予定)

講演要旨



講演 1 「ハイエンド半導体を支えるパネルレベルパッケージング技術と当社ボンダーソリューション」 竹内 裕之 (東レエンジニアリング株式会社)

AI や HPC をはじめとするハイエンド半導体では、高密度実装と大面積化への対応が求められている。本講演では、これを支えるパネルレベルパッケージング（PLP）の技術動向と課題を整理するとともに、TCB による高精度を実現する当社ボンダーソリューションの特長について紹介します。

講演 2 「半導体・電子デバイスでの 3D X 線解析が実現する品質言語化」 安達 佳孝 (オムロン株式会社)

先端半導体や電子デバイスの高性能化・複雑化が進む中、開発段階で得られた知見や品質情報を、いかに量産へ正しくつなげるかが重要な課題となっている。

多くの現場では、開発・解析・量産それぞれで異なる評価基準や判断軸が存在し、それが品質課題の早期発見や再現性確保の障害となっている。

本講演では、非破壊検査技術の進化を背景に、品質を定量的かつ客観的に捉え、開発から量産まで共通の尺度で活用する「品質共通言語」の考え方について提案する。

さらに、3D X 線解析が果たす役割を通じて、品質情報を組織や工程を横断して活用するためのアプローチと、次世代ものづくりに求められる品質保証の方向性について考察する。

講演 3 「Agentic AI の拡大で先端プロセス/先端 PKG の需要が切り上がる」山本 義継 (みずほ証券株式会社)

25 年終わり以降、Agentic AI の拡大が半導体需要に大きな影響を与えている。先端プロセス（プロセッサ、メモリ）の需要をさらに切り上げ、CoWoS/EMIB など先端 PKG の需要見通しも強くなっている。Agentic AI がなぜ需要を切り上げるのか、逆に、どのようなリスクがありえるのか、コメントする。

講演 4 「パネルレベルの最先端半導体パッケージに関する Resonac の取り組み（仮）」高橋 正樹 (株式会社レゾナック)

AI 半導体パッケージあたりのダイ搭載数は年々増加し、これを搭載するインターポーザは大型化する傾向にある。300 mm 径のシリコンウェハを使う場合、取り数の減少が懸念される。そのため、再配線層形成技術や封止成型技術を応用した、パネルレベルでの研究開発も進んでいる。本講演は、各種実装材料を用いたウェハレベルの試作評価内容を説明しつつ、パネルインターポーザに向けた取り組みを紹介する。

講演 5 「Nikon が提案する最先端半導体パッケージ向け配線技術」川上 雄介 (株式会社ニコン)

先端パッケージ分野では、ガラス基板や高機能有機基板の活用が進む一方、これらの難めっき基板上に高密度配線を形成するための、平滑性と密着性を両立した導体形成技術が求められている。

従来のめっきプロセスでは、密着性確保のための表面粗化や多段階前処理が必要であり、高周波伝送特性に有利な平滑界面との両立や、生産性が課題となっていた。

本講演では、光応答性表面処理材料を用いて露光部のみに選択的な無電解銅めっきを形成する Photo Assist Patterning (PAP) 技術について紹介する。

PAP は、従来の粗化処理を必要とせず、高平滑かつ高密着な銅配線を形成できる新しい導体形成技術である。

講演では、開発の背景と技術原理ならびにガラス基板や有機基板への適用事例を示し、その有効性と先端パッケージ基板への適用可能性について報告する。

講演 6 「Future is There ～コンピューティングの進化と転換点～」 高橋 志津（日本アイ・ビー・エム株式会社 / 京都リサーチパーク株式会社）

AI の急速な進化と普及により、エネルギー消費と計算需要はかつてない規模で拡大し、コンピューティングは新たな転換点を迎えています。本講演では、半導体、AI、量子コンピューティングの最新動向を通じて、新しい計算基盤の可能性と、発見の加速による新たな価値創造の未来を展望します。

ご案内



お申し込み

